



株式会社バイ・テクノロジー
2026年3月期(第28期) 第1四半期

決算説明資料

(2025年4月1日～2025年6月30日)

2025年8月8日

| 目次

2026年3月期(第28期) 第1四半期決算

1. 決算概況
2. 受注高・受注残高
3. 2026年3月期 業績予想と配当
4. 企業価値向上に向けた成長戦略
5. 主要財務データ
 - ・ セグメント別受注高・売上高の詳細
 - ・ 受注高および業績実績とガイダンス
 - ・ 貸借対照表・キャッシュフロー計算書

2026年3月期（第28期） 第1四半期決算

1. 決算概況

売上高:

前年同期比16.0%減

(主な要因)

- FPD装置事業: $\Delta 4,325$ 百万円
- 半導体・フォトマスク装置事業: $+ 2,820$ M

営業損失:

前年同期比434百万円縮小

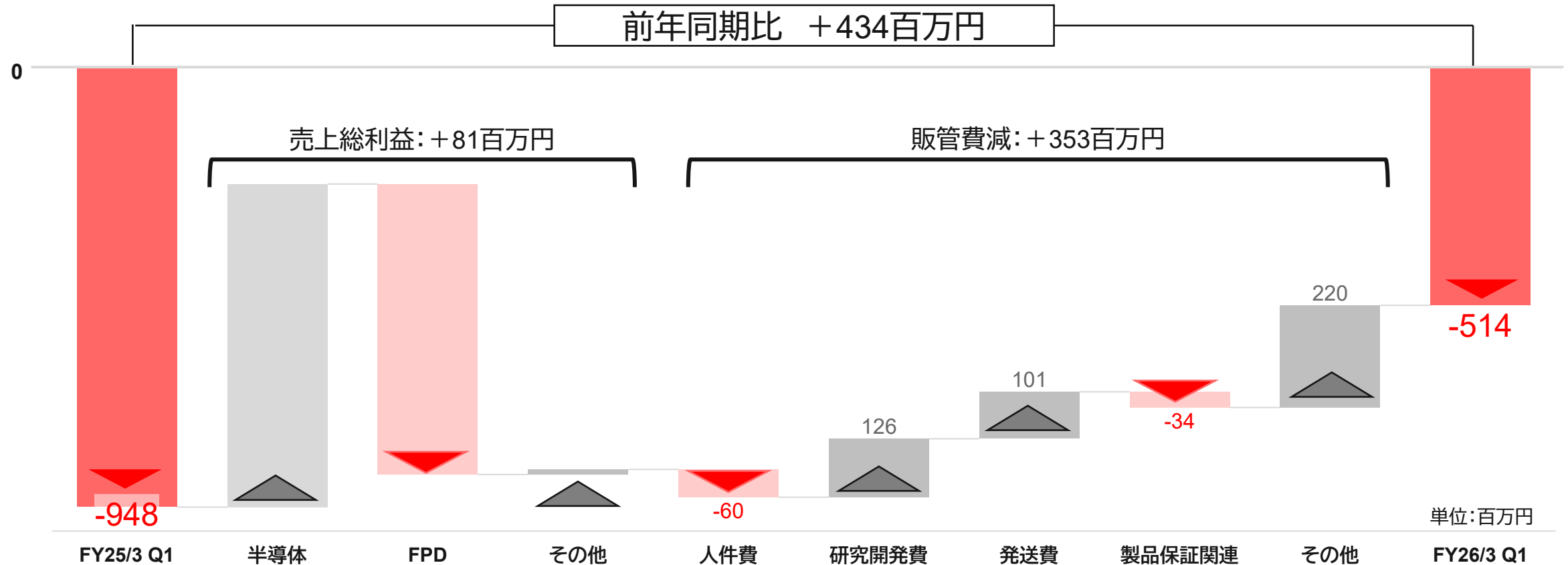
(主な要因)

- FPD装置事業: $+ 10$ 百万円
- 半導体・フォトマスク装置事業: $+ 385$ 百万円

(単位:百万円)	FY24/3 Q1	FY25/3 Q1	FY26/3 Q1	前年同期比 増減金額	前年同期比 増減率
売上高	5,749	9,523	7,998	$\Delta 1,525$	$\Delta 16.0\%$
営業利益 (Δ 損失)	$\Delta 641$	$\Delta 948$	$\Delta 514$	$+ 434$	—
営業利益率	—	—	—	—	—
経常利益 (Δ 損失)	$\Delta 410$	$\Delta 759$	$\Delta 589$	$+ 170$	—
親会社株主に 帰属する 四半期純利益	$\Delta 406$	$\Delta 656$	$\Delta 665$	$\Delta 9$	—

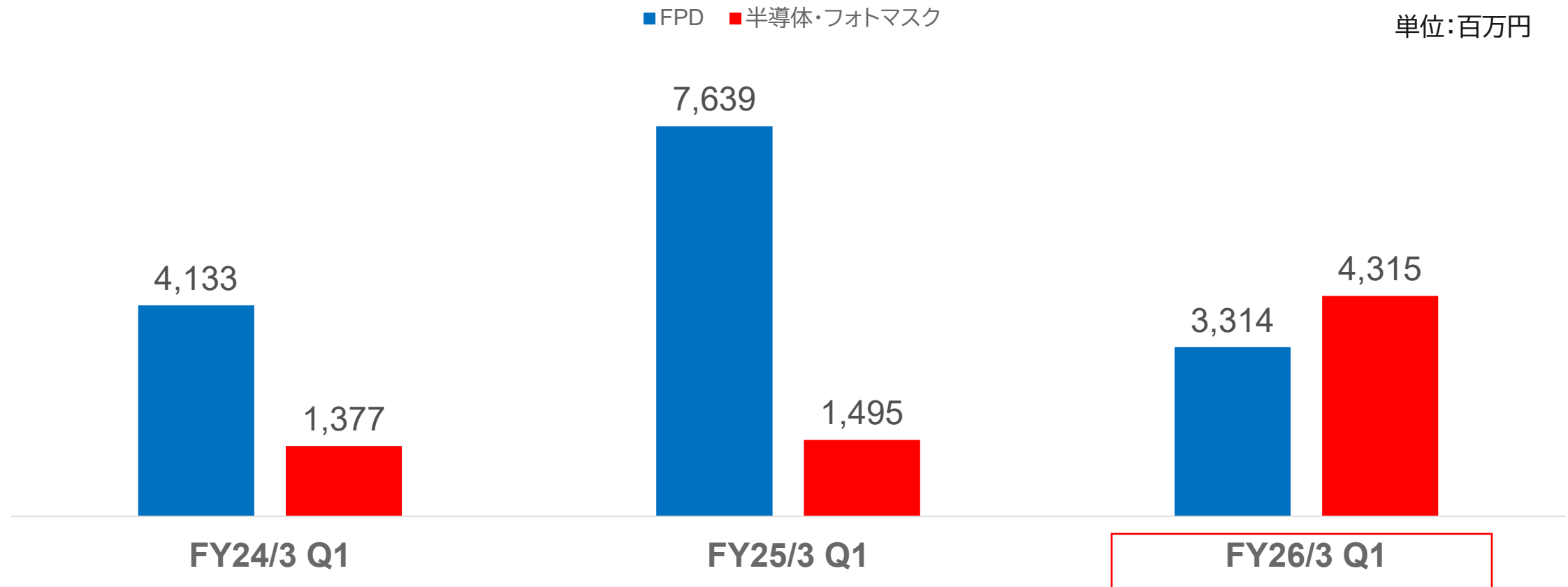
営業利益増減要因(対前年同期比)

- 半導体・フォトマスク装置事業の増益、販管費の削減効果等から、営業損失は縮小
- その他費用:220百万円
✓主に、販売手数料関連、及び、のれん償却費の減少による



セグメント別 売上高サマリー

- FPD装置 :前年Q1の大型案件の一巡により、露光装置の売上が減少し、前年同期比で減少
- 半導体・フォトマスク装置:アドバンスパッケージ・PCBの売上寄与が本格化、Q1売上として過去最高を記録

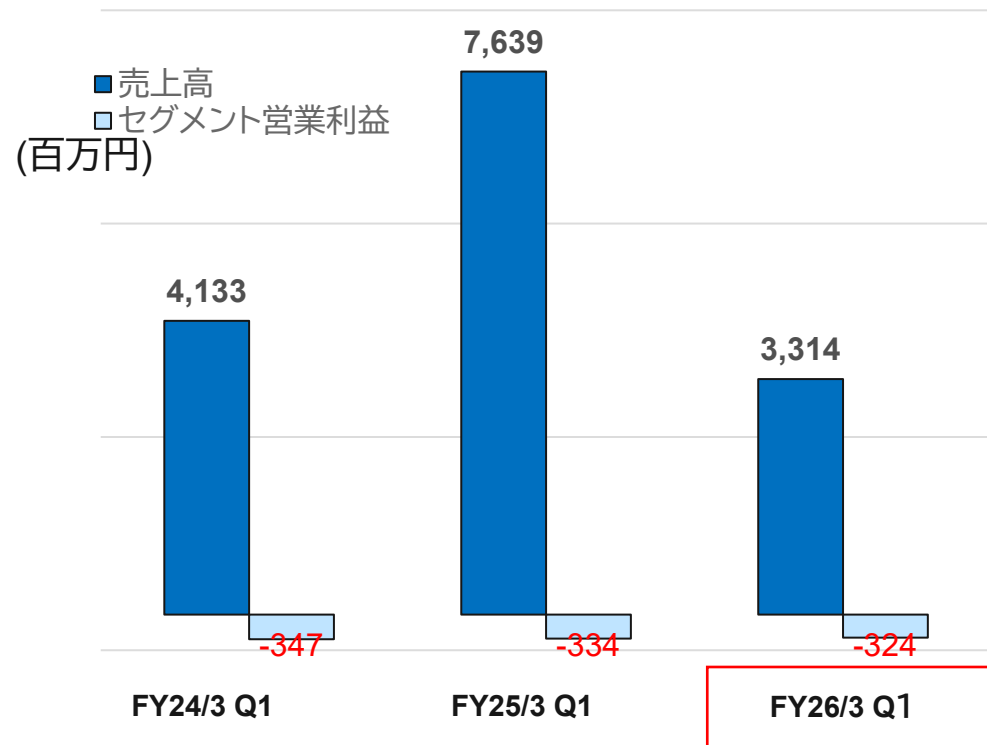


セグメント別 売上高・営業利益分析

2026年3月期 第1四半期
1. 決算概況

FPD装置

(単位:百万円)	FY24/3 Q1	FY25/3 Q1	FY26/3 Q1	前年同期比 増減金額	前年同期比 増減率
売上高	4,133	7,639	3,314	△4,325	△56.6%
セグメント営業利益	△347	△334	△324	+10	—



(概況)

大手顧客向け露光装置の設置が一巡

(売上利益)

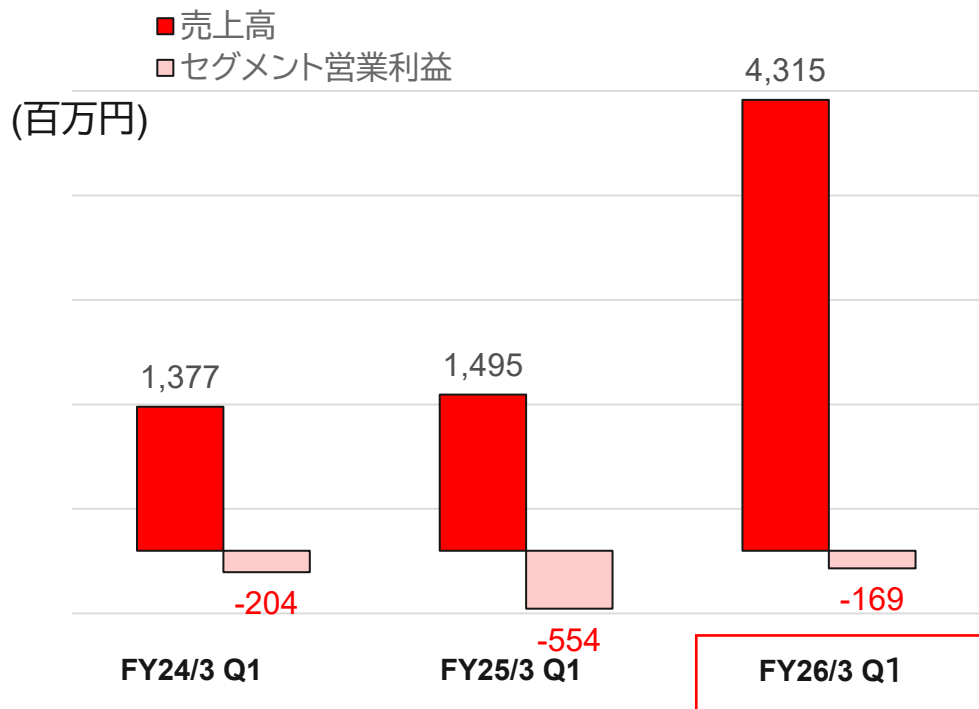
- 計画比
 - ✓ 売上、営業利益とも概ね想定線で推移
- 前年同期期比(売上)
 - ✓ 装置販売台数の減少により大幅減収
- 前年同期期比(利益)
 - ✓ 売上原価及び販管費削減により営業損失は横ばい

セグメント別 売上高・営業利益分析

2026年3月期 第1四半期
1. 決算概況

半導体・フォトマスク装置

(単位:百万円)	FY24/3 Q1	FY25/3 Q1	FY26/3 Q1	前年同期比 増減金額	前年同期比 増減率
売上高	1, 377	1, 495	4,315	+2,820	+ 188.6%
セグメント営業利益	△204	△554	△169	+385	—



(概況)

アドバンストパッケージ・PCBの売上寄与が本格化

(売上利益)

- 計画比
 - ✓ 客設置計画の延伸があったものの影響は軽微、通期計画の変更無し
- 前年同期比(売上)
 - ✓ アドバンストパッケージ関連に加え、フォトマスク、ウェハ関連も増加
- 前年同期比(利益)
 - ✓ 主に売上増により損失は大幅に縮小

2026年3月期（第28期） 第1四半期決算

2. 受注高・受注残高

受注高・受注残高の概況

FPD装置 : 受注高・受注残ともに、概ね想定通り推移

半導体・フォトマスク装置: フォトマスクおよびアドバンストパッケージ関連で遅れが見られるが挽回可能

受注高 : 前年同期比617百万円減

- FPDは受注高が△1,890百万円減少、半導体・フォトマスクは1,291百万円増加

受注残高: 前年同期比7,472百万円増

- FPDは受注残が7,343百万円、半導体・フォトマスクは128百万円増加

来期売上高660億円の達成に向けて

- 26年3月末受注残460億円(装置販売の8割程度)を目標に、半導体・フォトマスクの受注活動に注力

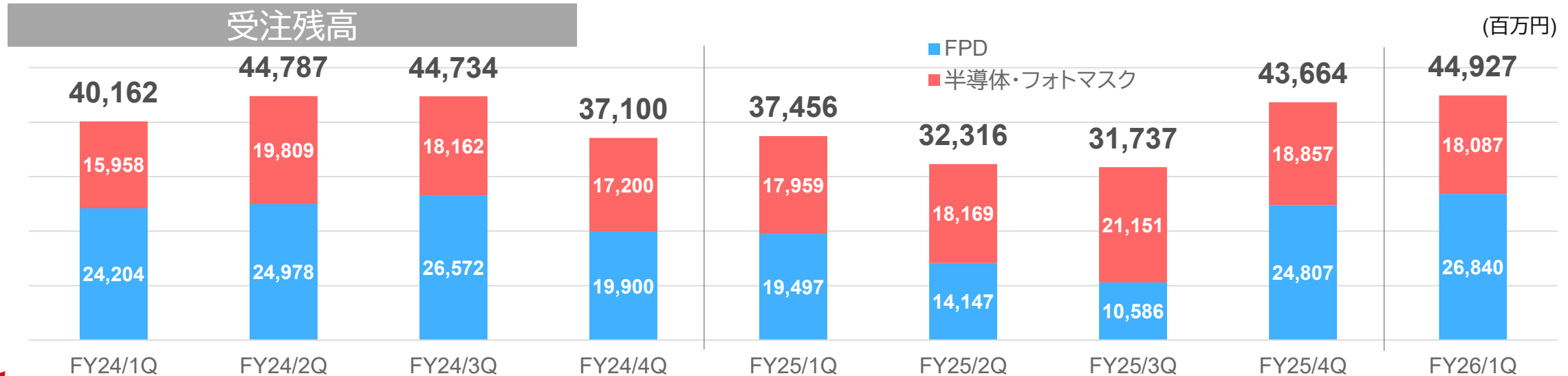
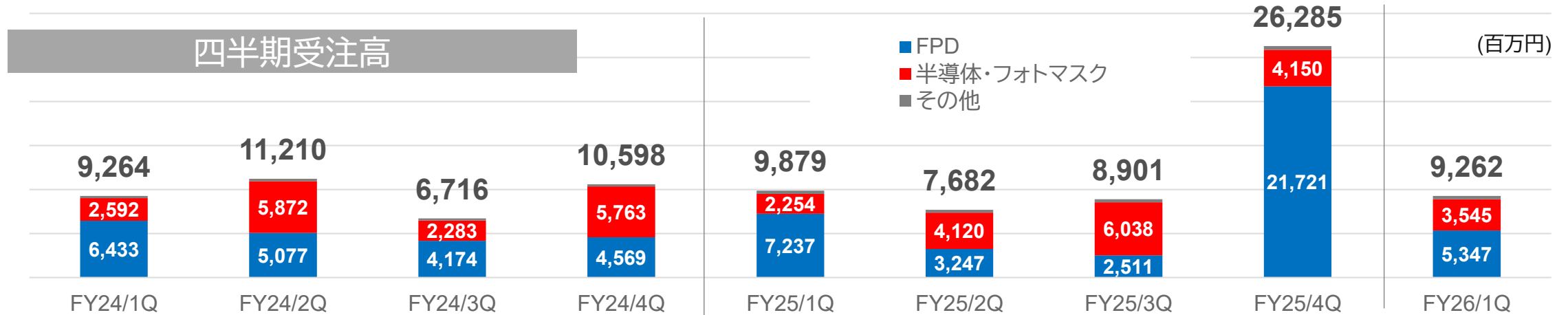
(単位:百万円)	FY25/3 Q1	FY26/3 Q1	前年同期比 増減金額	前年同期比 増減率	(参考) 通期予想
受注高	9,879	9,262	△617	△6.2%	—
受注残高	37,456	44,928	7,472	+ 19.9%	46,000

セグメント別 受注高・受注残高分析

(単位:百万円)		FY25/3Q1	FY26/3Q1	前年同期比 増減金額	前年同期比 増減率	事業概況
FPD装置	受注高	7,237	5,347	△1,890	△26.1%	10.5Gの既存工場向け設備投資 - 露光装置、修正装置が増加、検査装置が減少 - 前年同期比では、検査装置の受注減少
	受注残高	19,497	26,840	7,343	+37.7%	露光・修正装置を中心に、下期の売上計上を想定
半導体・ フォトマスク 装置	受注高	2,254	3,545	1,291	57.3%	- 半導体を中心に伸長 - アドバンストパッケージの受注堅調
	受注残高	17,959	18,087	128	0.71%	当下期および来期売上計画の達成に向け、特に、アドバンストパッケージ分野の受注活動に注力

四半期受注高・受注残高の推移

FPD装置の大型受注は一巡、今後は半導体・フォトマスク関連の受注拡大を想定



2026年3月期（第28期） 第1四半期決算

3. 業績予想と配当

2026年3月期業績予想の変更なし

- 前期同様に下期偏重の利益貢献を想定、2Q累計で前年同期並みの営業赤字の社内想定に沿い1Q進捗
- 製品収益ミクスの改善が下期に本格化へ

(単位:百万円)	FY25/3Q1	FY25/3通期	FY26/3 (通期予想)	FY26/3Q1	Q1前期比 増減金額	Q1前期比 増減率
売上高	9,523	46,182	56,000	7,998	△1,525	△16.0%
営業利益 (△損失)	△948	1,821	4,500	△514	+434	—
営業利益率	—	3.9%	8.0%	—	—	—
経常利益 (△損失)	△759	1,891	4,200	△589	+170	—
当期(四半期) 純利益(△損失)	△656	800	2,700	△665	△9	—

配当と株主還元について

業績計画達成に全社的に取り組むと同時に安定配当を目指す

- 配当政策
 - ✓事業拡大に向けたM&A、設備投資等、経営基盤の強化に向けて、必要な内部留保の充実を勘案した上で、配当の安定性・継続性・配当性向等を考慮
 - ✓経営成績に応じた利益還元を行なう方針
- 株主還元の充実を図るため、機動的な自己株式取得、及び配当の増額等を引き続き検討

項目		FY21/3	FY22/3	FY23/3	FY24/3	FY25/3	FY26/3(予想)
配当金額(総額/百万円)		1,176	1,176	882	586	764	756
配当性向(%)		21.40	30.60	334.70	74.20	95.20	28.00
一株当たり 配当金(円)	中間	60	60	60	30	40	40
	期末	60	60	30	30	40	40
	総額	120	120	90	60	80	80

4. 企業価値向上に向けた成長戦略

ROE20%超達成は最重点目標

	25.3期	26.3期(予)	27.3期(予)	29.3期(予)
ROE	2.4%	8.2%	12.5%	23.7%

1. 収益性の拡大

- 営業利益率 25.3期 3.9%→29.3期 20%への拡大を目指す。
- 新製品の収益貢献とM&Aによるトップラインの伸長を図る。
- 高粗利率の半導体・フォトマスク装置の売上構成の拡大によるミクス改善。

2. 資産効率の改善

- 部材調達・装置出荷リードタイムの抜本的な改善に取り組む。
- 見込み生産を削減し、在庫水準の最適化を図る。
- M&Aによる資産効率改善に期待。

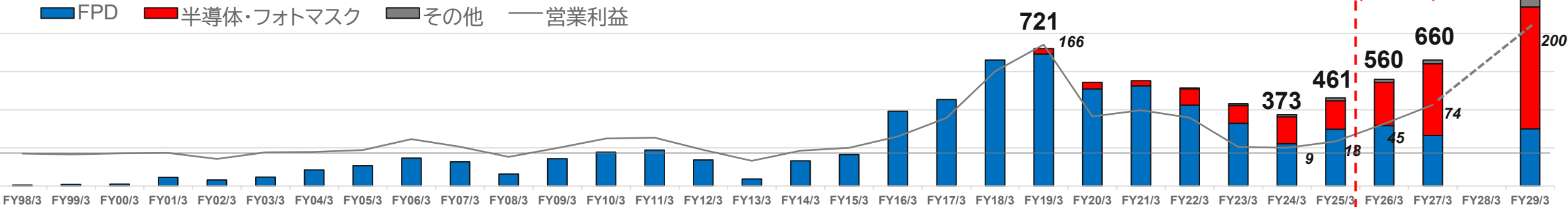
3. 財務レバレッジの上昇

- 成長に向けた投資フェーズにあることから、M&A等へのキャッシュアウトを最優先。
- タイムリーな投資のために一定範囲の財務レバレッジ上昇を想定。
- 株主還元は配当を重視するが、自社株買いは機動的に実施する。

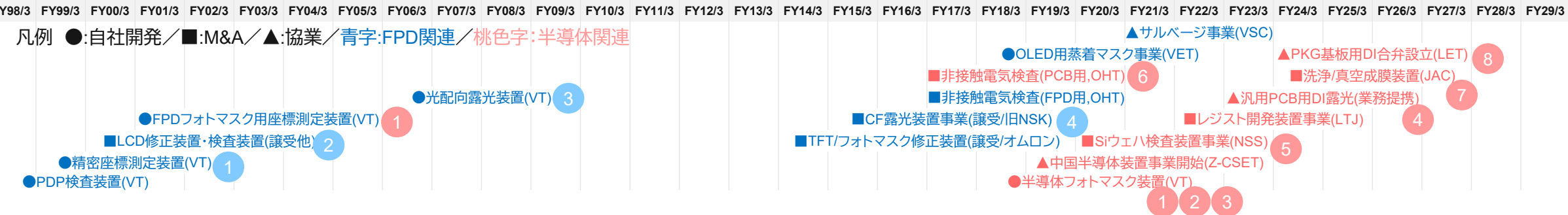
FPDから半導体へ ～事業成長と、M&A+R&Dによる製品群拡大の歴史～

4. 企業価値向上に向けた
成長戦略

売上高と営業利益の推移(単位:億円)



M&Aと自社R&Dによる事業拡大の歴史



主要製品 (品名)

座標測定 (Mercury)

欠陥修正 (Jupiter)

光配向露光 (AEGIS)

CF露光 (RZ)

サブセグメント

検査

製造装置

事業セグメント

FPD装置事業

座標測定 (PMARS)

欠陥修正 (Pictor)

検査 (Dione)

自動現像 (LITHOTRAC)

Siウェハ検査 (MS-1000)

O/Sテスター (LIBRA)

PCB用DI

PKG用DI (Imagina/LAMBDI)

フォトマスク

半導体

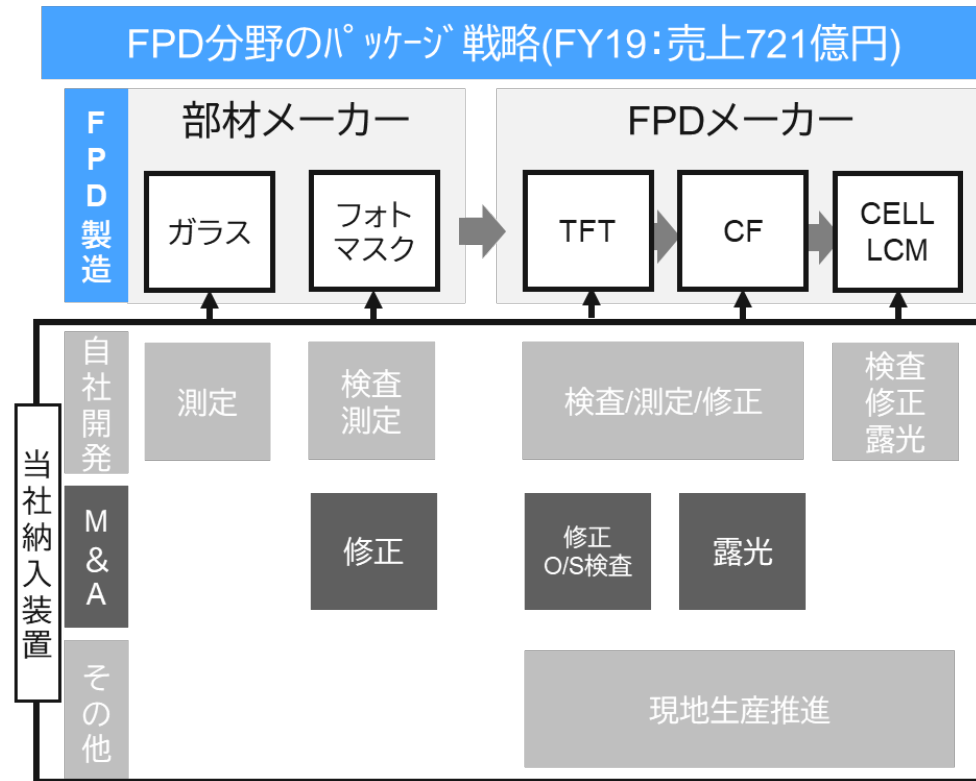
アドバンスパッケージ・PCB

半導体・フォトマスク装置事業

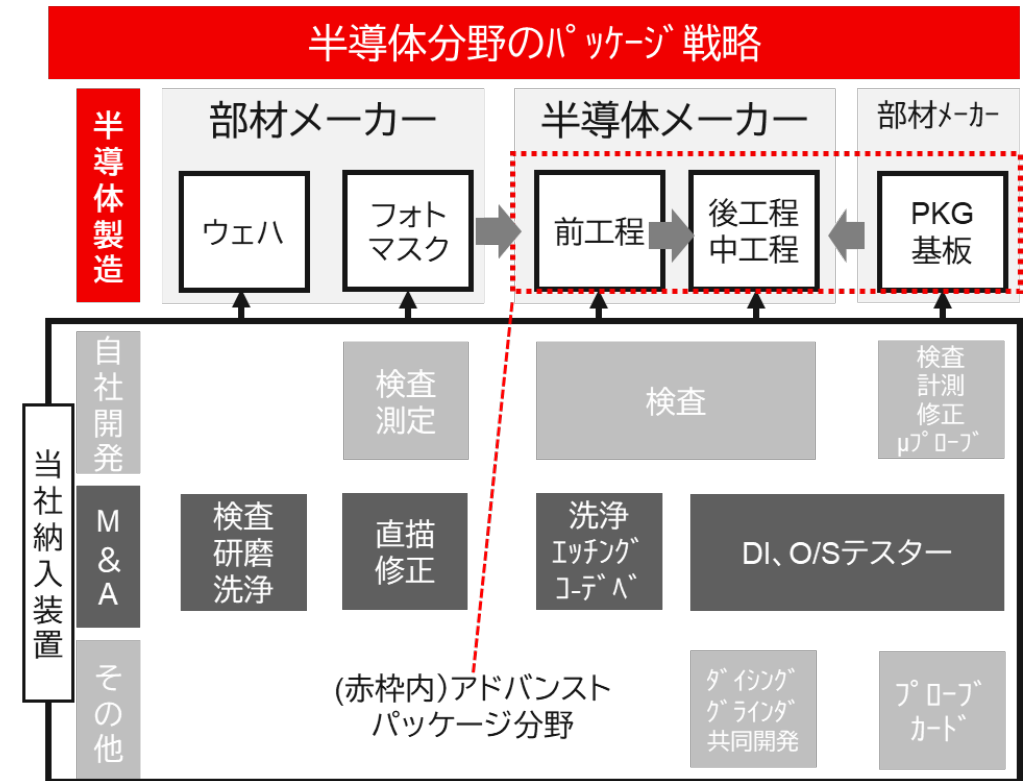
半導体分野へパッケージ戦略を展開

半導体分野にパッケージ戦略を展開、新製品、新事業を創出、事業拡大を目指す

- ✓ フォトマスク、半導体(ウェハ/ラボ用装置/他)、アドバンストパッケージ・PCB分野に注目
- ✓ 自社開発×M&Aで、製品ラインナップを広げ、市場を幅広く開拓、顧客とのネットワークを多面的に構築、製品開発に活用



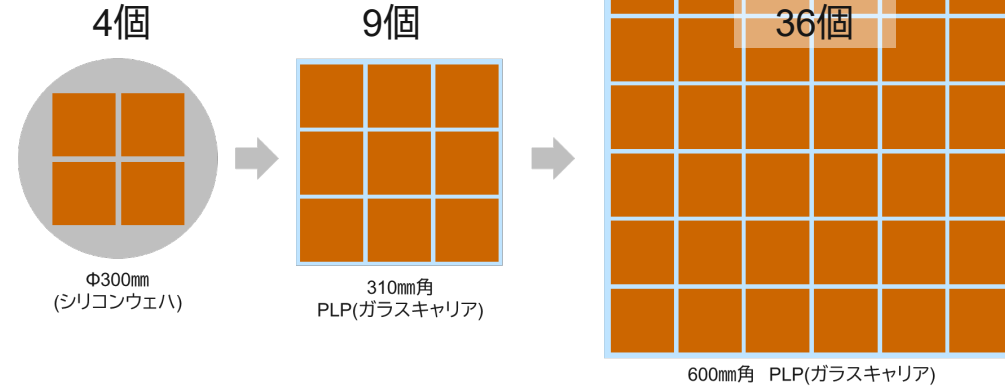
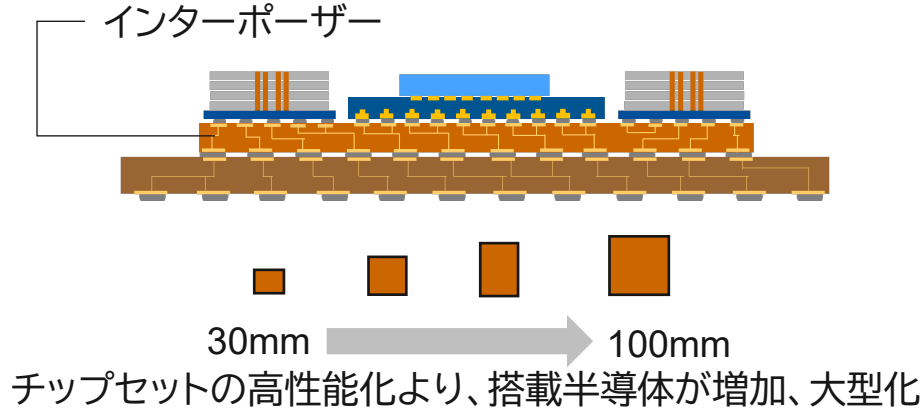
展開



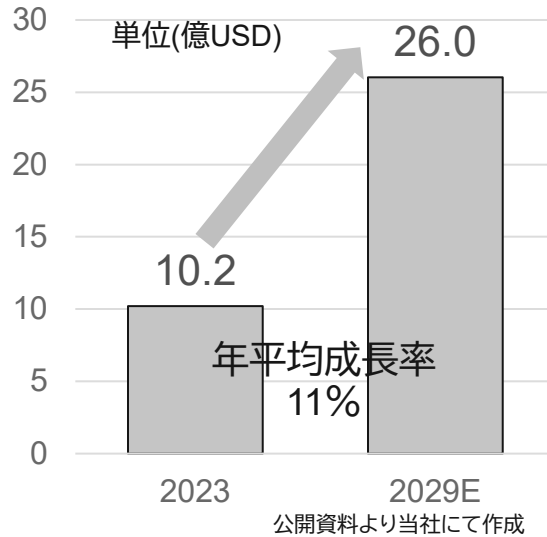
PLP(インターポージャー)及びパッケージ基板と当社製品

インターポージャーの大型化

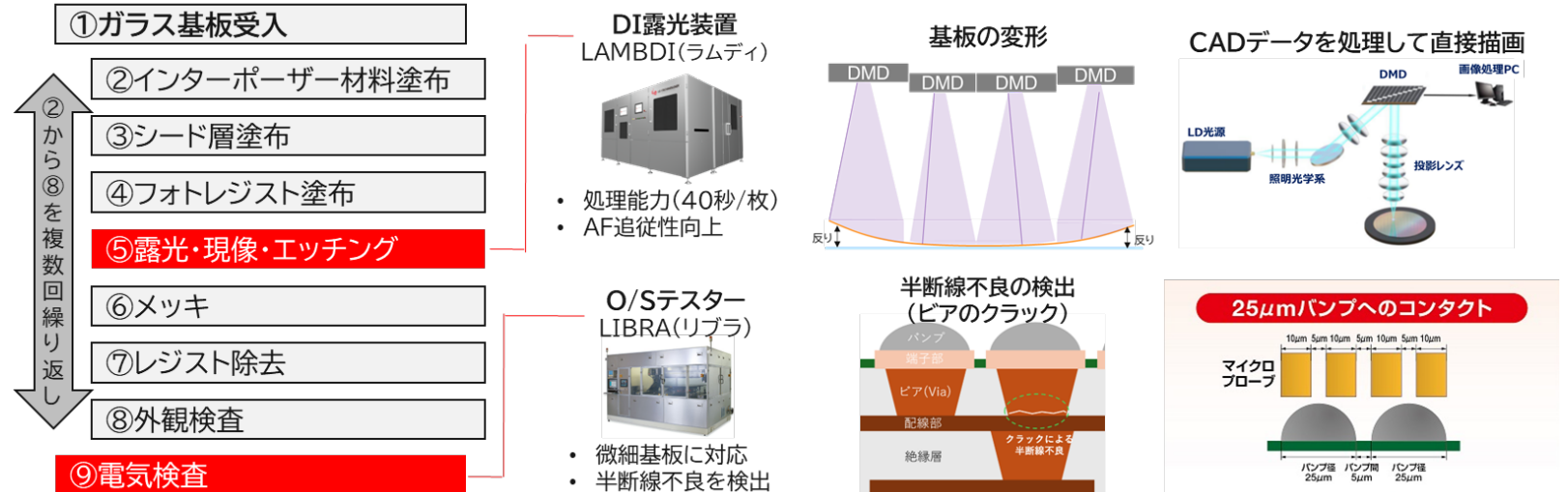
インターポージャーの高効率生産に向けて、基板の大型化が進む



アドバンストパッケージ市場



樹脂インターポージャー製造工程例と、当社製品および特長



5. 主要財務データ

セグメント別受注高・売上高の詳細 (単位:百万円)

項目	2024/3	2025/3	2026/3	2024/3				2025/3				2026/3	構成比	Q/Q%	YoY%
			予想	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q			
受注 FPD装置	20,254	34,716	—	6,433	5,077	4,174	4,569	7,237	3,248	2,511	21,721	5,347	57.7%	-75.4%	-26.1%
検査	7,898	13,325	—	1,037	3,604	2,285	973	2,944	1,731	1,137	7,513	1,839	19.9%	-75.5%	-37.5%
製造	6,839	15,168	—	4,339	-1	554	1,948	2,905	0	258	12,005	2,287	24.7%	-80.9%	-21.3%
メンテナンス	5,517	6,224	—	1,058	1,475	1,336	1,649	1,388	1,516	1,116	2,204	1,220	13.2%	-44.6%	-12.1%
半導体フォトマスク	16,444	16,562	—	2,592	5,872	2,283	5,763	2,255	4,120	6,037	4,151	3,547	38.3%	-14.6%	57.3%
フォトマスク	6,670	2,645	—	250	2,790	484	3,146	590	700	1,351	4	0	0.0%	—	—
半導体(ウェハ製造、ラボ等)	7,549	9,393	—	2,281	1,988	1,299	1,982	960	2,564	3,151	2,719	2,598	28.1%	-4.5%	170.6%
アドバンストパッケージ・PCB	2,226	4,524	—	63	1,095	500	634	705	856	1,536	1,428	949	10.2%	-33.5%	34.6%
その他	1,090	1,469	—	239	261	258	266	388	314	354	413	368	4.0%	-10.9%	-5.2%
受注高合計	37,788	52,747	—	9,264	11,210	6,716	10,598	9,880	7,681	8,901	26,285	9,262	100.0%	-64.8%	-6.3%
FPD装置比率	53.6%	65.8%	—	69.4%	45.3%	62.2%	43.1%	73.2%	42.3%	28.2%	82.6%	57.7%	57.7%	—	—
半導体フォトマスク比率	43.5%	31.4%	—	28.0%	52.4%	34.0%	54.4%	22.8%	53.6%	67.8%	15.8%	38.3%	38.3%	—	—
受注残高	37,100	43,664	46,000	40,162	44,787	44,734	37,100	37,456	32,316	31,737	43,664	44,928	—	—	—
売上 FPD装置	22,259	29,809	31,689	4,133	4,303	2,581	11,242	7,639	8,598	6,071	7,501	3,314	23.1%	-55.8%	-56.6%
検査	7,213	12,996	16,208	197	308	832	5,876	3,648	3,859	2,895	2,594	2,182	15.2%	-15.9%	-40.2%
製造	9,310	10,503	9,333	2,620	2,599	314	3,777	2,591	3,065	1,654	3,193	266	1.9%	-91.7%	-89.7%
メンテナンス	5,736	6,310	6,148	1,316	1,397	1,435	1,588	1,400	1,674	1,522	1,714	866	6.0%	-49.5%	-38.1%
半導体フォトマスク	14,053	14,905	22,677	1,377	2,020	3,931	6,724	1,495	3,911	3,055	6,444	4,316	30.1%	-33.0%	188.7%
フォトマスク	3,950	4,860	5,360	67	270	862	2,751	734	1,687	985	1,455	1,536	10.7%	5.6%	109.3%
半導体(ウェハ製造、ラボ等)	7,741	7,967	10,115	831	1,377	2,122	3,412	642	2,116	1,542	3,667	1,327	9.2%	-63.8%	106.7%
アドバンストパッケージ・PCB	2,362	2,078	7,202	480	374	947	627	120	108	527	1,323	1,454	10.1%	9.9%	1111.7%
その他	1,024	1,469	1,634	239	261	258	266	388	314	354	413	368	2.6%	-10.9%	-5.2%
売上高合計	37,336	46,183	56,000	5,749	6,585	6,769	18,231	9,523	12,822	9,479	14,358	7,999	55.7%	-44.3%	-16.0%
FPD装置比率	59.6%	64.5%	56.6%	71.9%	65.3%	38.1%	61.7%	80.2%	67.1%	64.0%	52.2%	41.4%	—	—	—
半導体フォトマスク比率	37.6%	32.3%	40.5%	24.0%	30.7%	58.1%	36.9%	15.7%	30.5%	32.2%	44.9%	54.0%	—	—	—

受注高および業績実績とガイダンス (単位:百万円)

項目	2018/3	2019/3	2020/3	2021/3	2022/3	2023/3	2024/3	2025/3	2026/3E	2025/3				2026/3		
										1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	Q/Q%	YoY%
受注高	109,323	47,430	22,532	36,980	53,200	37,072	37,788	52,747	—	9,879	7,682	8,901	26,285	9,262	-64.8%	-6.2%
受注残高	115,637	90,935	59,145	40,939	42,721	36,647	37,100	43,664	46,000	37,456	32,316	31,737	43,664	44,928	2.9%	19.9%
売上高	66,067	72,132	54,322	55,186	51,418	43,146	37,335	46,182	56,000	9,523	12,822	9,479	14,358	7,998	-44.3%	-16.0%
売上総利益	21,321	25,144	15,122	15,704	15,486	10,946	10,604	12,130	—	1,773	3,375	2,547	4,435	1,854	38.5%	246.5%
営業利益	12,545	16,628	5,653	6,604	5,461	986	846	1,821	4,500	-948	812	192	1,765	-514	-129.1%	-45.8%
営業外収益	55	209	623	395	518	935	551	517	—	287	-154	353	31	139	348.4%	-51.6%
営業外費用	230	70	121	163	111	222	285	447	—	97	175	76	99	215	117.2%	121.6%
経常利益	12,370	16,767	6,156	6,836	5,868	1,700	1,112	1,891	4,200	-759	484	469	1,697	-589	-134.7%	-22.4%
税前利益	12,256	16,892	6,191	7,054	6,450	1,571	1,181	1,383	—	-721	504	451	1,149	-633	-155.1%	-12.2%
法人税等	3,399	4,517	2,054	2,462	2,194	1,434	603	781	—	-6	101	213	473	60	-87.3%	-1100.0%
親会社株主当期純利益	7,837	10,901	3,251	3,513	4,198	260	778	800	2,700	-656	438	271	747	-665	-189.0%	1.4%
1株当たり当期純利益	1582.84	2217.48	336.29	363.41	434.21	26.92	80.65	84.07	265.71	-68.22	45.41	28.44	78.44	-70.46	-189.8%	3.3%
1株当たり配当金	270	320	120	120	120	90	60	80	80	—	40	—	40	—	—	—
1株当たり純資産	3865.50	5552.32	2926.03	3233.74	3534.40	3475.25	3571.35	3544.98	—	—	—	—	3544.98	—	—	—
売上高総利益率	32.3%	34.9%	27.8%	28.5%	30.1%	25.4%	28.4%	26.3%	—	18.6%	26.3%	26.9%	30.9%	23.2%	—	—
売上高営業利益率	19.0%	23.1%	10.4%	12.0%	10.6%	2.3%	2.3%	3.9%	8.0%	-10.0%	6.3%	2.0%	12.3%	-6.4%	—	—
売上高経常利益率	18.7%	23.2%	11.3%	12.4%	11.4%	3.9%	3.0%	4.1%	7.5%	-8.0%	3.8%	4.9%	11.8%	-7.4%	—	—
法人税率	27.7%	26.7%	33.2%	34.9%	34.0%	91.3%	51.1%	56.5%	—	0.8%	20.0%	47.2%	41.2%	-9.5%	—	—
売上高当期純利益率	11.9%	15.1%	6.0%	6.4%	8.2%	0.6%	2.1%	1.7%	4.8%	-6.9%	3.4%	2.9%	5.2%	-8.3%	—	—
自己資本利益率(ROE)	40.9%	40.6%	11.5%	11.2%	12.7%	0.8%	2.3%	2.4%	8.2%	-2.0%	1.3%	0.8%	2.2%	-2.0%	—	—
自己資本	19,139	26,844	28,293	31,268	32,980	32,842	34,372	33,500	—	33,611	32,976	33,153	33,500	32,634	—	—

貸借対照表・キャッシュフロー計算書 (単位:百万円)

	2018/3	2019/3	2020/3	2021/3	2022/3	2023/3	2024/3	2025/3	2025/3 1Q	2Q	3Q	4Q	2026/3 1Q	Q/Q%	YoY%
資産の部															
現金及び預金	22,281	19,836	12,101	33,278	27,898	26,729	23,096	26,671	25,063	28,930	26,196	26,671	23,129	-13.3%	-7.7%
受取手形・売掛金	21,019	25,518	24,132	19,329	19,537	22,408	24,716	19,786	20,332	21,681	20,181	19,786	18,085	-8.6%	-11.1%
棚卸資産	14,071	24,028	24,854	15,956	11,405	10,089	15,531	15,495	16,408	15,052	17,057	15,495	18,196	17.4%	10.9%
商品及び貯蔵品	227	171	123	196	176	338	477	679	443	787	788	679	941	38.6%	112.4%
仕掛品	13,118	22,756	23,126	13,977	9,428	7,219	12,274	10,707	12,881	11,374	12,951	10,707	12,612	17.8%	-2.1%
原材料及び貯蔵品	726	1,101	1,605	1,783	1,801	2,532	2,780	4,109	3,084	2,891	3,318	4,109	4,643	13.0%	50.6%
流動資産	62,209	74,699	66,494	71,379	63,085	62,621	67,045	65,392	65,537	69,073	67,255	65,392	62,922	-3.8%	-4.0%
有形固定資産	977	3,274	4,539	4,382	4,720	4,034	4,098	3,859	4,305	4,261	4,221	3,859	4,403	14.1%	2.3%
無形固定資産	253	189	1,592	1,625	1,495	1,460	886	712	1,000	957	879	712	648	-9.0%	-35.2%
投資その他の資産	1,344	2,141	2,493	3,203	3,300	3,270	3,575	3,235	3,553	3,190	3,105	3,235	3,157	-2.4%	-11.1%
資産合計	64,786	80,304	75,119	80,591	72,601	71,387	75,606	73,201	74,397	77,483	75,461	73,201	71,132	-2.8%	-4.4%
負債の部															
支払手形・買掛金	10,861	12,505	8,095	6,477	6,323	4,039	5,429	4,918	5,296	4,778	4,932	4,918	5,735	9.3%	1.5%
短期借入金	2,491	2,450	200	120	394	663	866	1,295	1,386	1,704	1,685	1,295	1,297	0.2%	-6.4%
前受金	14,868	22,320	18,202	15,061	8,334	8,221	4,496	5,037	5,645	5,638	5,113	5,037	5,563	10.4%	-1.5%
流動負債	40,963	50,517	36,539	34,195	27,061	23,922	29,299	24,263	29,905	26,474	25,650	24,263	24,404	0.6%	-18.4%
長期借入金	2,256	1,332	8,861	12,964	10,243	12,662	10,550	14,254	9,482	16,745	15,420	14,254	12,819	-10.1%	35.2%
純資産	21,114	27,985	29,361	32,195	34,540	33,884	34,639	33,581	33,841	33,154	33,300	33,581	32,691	-2.7%	-3.4%
自己資本	19,139	26,844	28,293	31,268	34,175	33,604	34,372	33,500	33,611	32,976	33,153	33,500	32,634	-2.6%	-2.9%
連結CF															
営業活動によるCF	8,526	6,531	-7,853	20,173	1,408	-3,284	-4,764	5,344	—	—	—	—	—	—	—
投資活動によるCF	-434	-2,617	-3,828	-1,251	-1,554	-1,195	-440	-1,470	—	—	—	—	—	—	—
フリーキャッシュ・フロー	8,092	3,914	-11,681	18,922	-146	-4,479	-5,204	3,874	—	—	—	—	—	—	—
自己株式取得	-	-1,999	0	-512	0	0	-99	-499	—	—	—	—	—	—	—
配当金支払額	-866	-1,634	-1,547	-974	-1,176	-1,176	-588	-675	—	—	—	—	—	—	—
財務活動によるCF	-2,150	-6,385	4,074	1,972	-5,839	2,780	1,526	-471	—	—	—	—	—	—	—

注記事項

・将来見通し

本資料に記載されている当社の計画、戦略、見通し及びその他の歴史的事実でないものは、将来に関する見通しであり、これらは現在入手可能な期待、見積、予想に基づいています。これらの期待、見積、予想は、経済情勢・市況の変化、競争環境の変化、顧客のある国の政策変化、係争中及び将来の訴訟の結果など多くの潜在的リスク、不確実な要素、過程の影響を受けますので、実際の業績は見通しから大きく異なる結果となる可能性があります。従って、これら将来予想に関する記述に全面的に依拠することは差し控えて頂きますようお願いいたします。また、当社は新しい情報、将来の出来事などに基づきこれらの将来予測を更新する義務を負うものではありません。

・数字の処理

記載された金額は、単位未満を切り捨て処理、比率は単位金額で処理した結果を四捨五入している為、内訳と一致しない場合があります。

・事業セグメントの構成

✓ 半導体・フォトマスク装置事業

半導体製造工程における製造装置、検査装置及びフォトマスク用装置等の開発・設計・製造・販売・関連サービス、及びPCB用装置で構成されています。

✓ FPD装置事業

FPD製造工程における製造装置、検査装置等の開発、設計、製造、販売、関連サービス及びOLED用蒸着マスクをはじめとする部材等で構成されています。

お問合せ先
IR室
vtj-ir@vtec.co.jp

